



Ampoc Far East Co., Ltd.

揚博科技股份有限公司
Ampoc Far-East Co., Ltd.

股票代號：2493



2020/09/17



- 一、公司簡介
- 二、公司沿革
- 三、產業應用與產品介紹
- 四、財務資訊
- 五、未來展望





一、公司簡介

公司名稱	揚博科技股份有限公司
地址	台北市松德路171號17樓
電話	(02)2726-2220
董事長	蘇勝義 先生
總經理	喬鴻培 先生
資本額	新台幣 114,437 萬元
設立日期	1980年11月1日
員工人數	280人
公司網站	www.ampoc.com.tw



蘇勝義先生



二、公司沿革

AMPOC's History



- 2019/01 • 透過香港子公司投資 Ampec Trading (Shanghai) Co., Ltd.。
- 2006/12 • 吸收合併百分之百持有之揚鑫投資股份有限公司，合併後資本額不變。
- 2002/01 • 經證管會核准於 2002/1/23 股票掛牌上市，代號 2493。
- 2001/06 • 申請公司名稱變更為「揚博科技股份有限公司」，盈餘轉增資，股本增加為 90,500 萬元。
- 2000/10 • 辦理現金增資 4,800 萬元、盈餘轉增資 3,997 萬元、合併資本公積轉增資 7,424 萬元、員工紅利轉增資 401 萬元，增資後資本額為新台幣 73,729 萬元。
- 1999/12 • 合併台北化工機械股份有限公司，並增資發行新股 21,107 仟股，股本增為 57,107 萬元。
- 1998/12 • 獲准成為公開發行公司，辦理盈餘轉增資 10,200 萬元，增資後資本額為新台幣 30,000 萬元。
- 1998/03 • 設立精密儀器檢測服務實驗室，加強對客戶服務內容與品質。
- 1997/03 • 購置並遷入台北市松德路 171 號 17 樓之新辦公室。
- 1987/05 • 日本 TCM 於中壢工業區設立台北化工機械股份有限公司，產製 PCB 濕製程設備，本公司除參與投資外並取得日本以外全球獨家銷售權。
- 1980/11 • 揚博企業股份有限公司成立，股本 100 萬元。



三、產業應用與產品介紹

□ 產業應用

- 半導體前段
- 先進封裝製程
- 5G/AI

□ 產品介紹

- ABF垂直Ampoc Wing 系統
- Laser Heater TC Bonder



Ampoc Far East Co., Ltd.



產業應用





產業應用-核心發展策略

- ✓ 覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液。
- ✓ 3D-IC · FOWLP 高速電鍍藥水。
- ✓ 晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液。
- ✓ 高解析光阻液。
- ✓ Hard Mask

半導體
前段

先進
封裝

5G/AI

- ✓ 導線架 metal finish 用藥水。
- ✓ QFN導線架&石英震盪器電著光阻。

- ✓ AiP (Antenna in Package) 測試應用設備。
- ✓ 5G通訊晶片測試MLO探針卡。

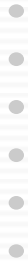


主要客戶群與合作夥伴





Ampoc Far East Co., Ltd.



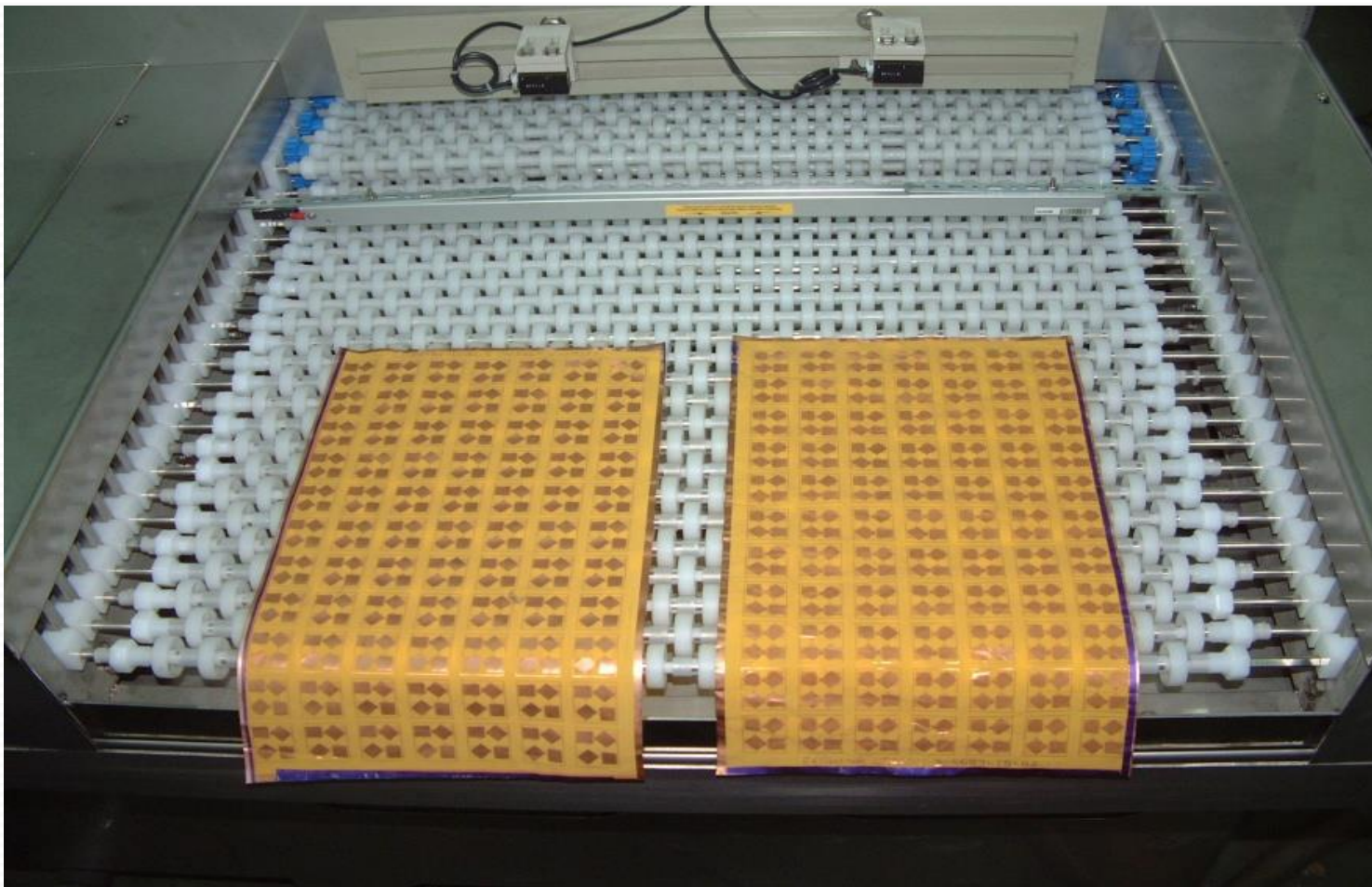
產品介紹





Ampoc Far East Co., Ltd.

傳統水平式設備：板面接觸滾輪造成刮傷與汙染問題

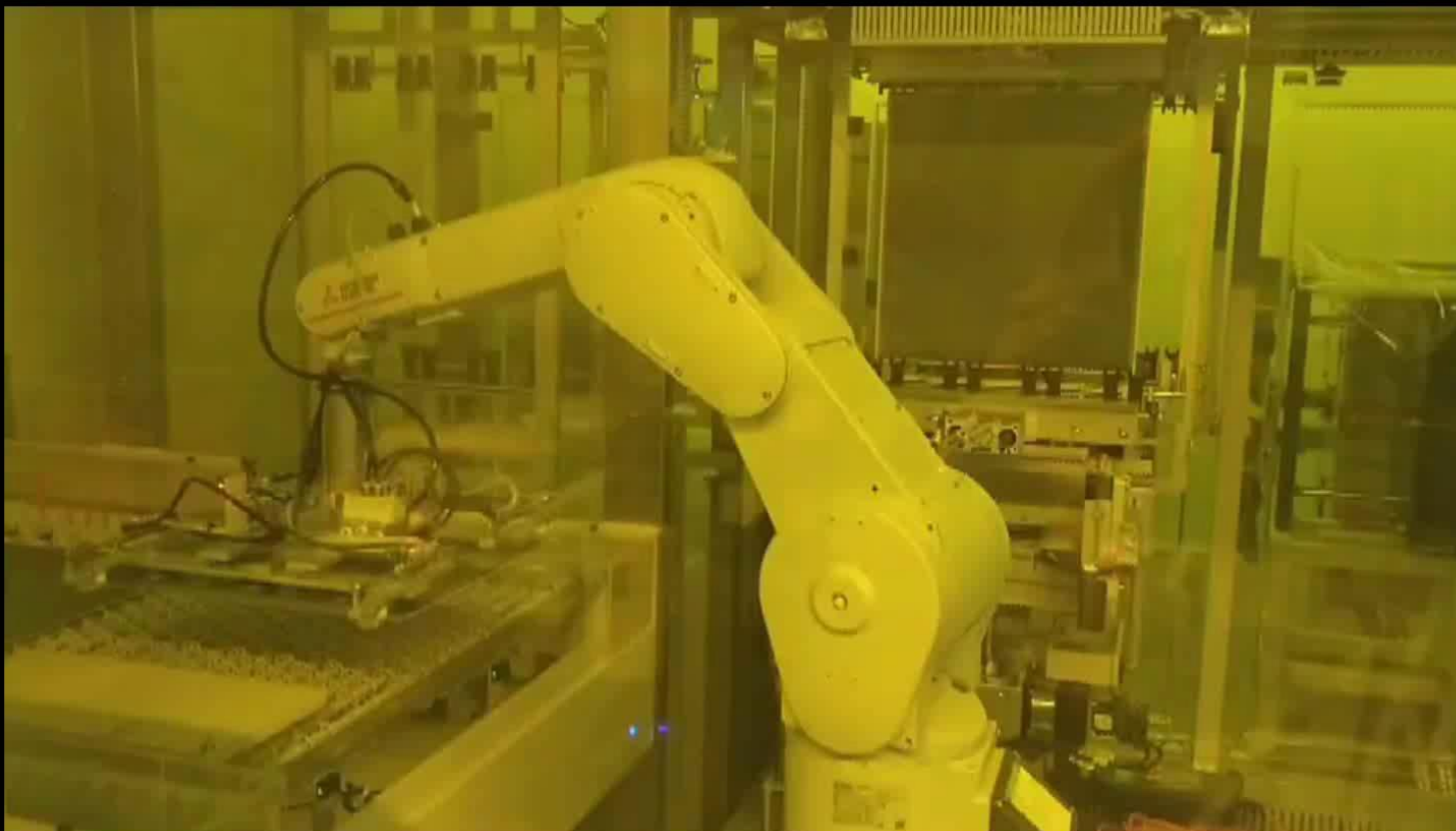




Ampoc Far East Co., Ltd.

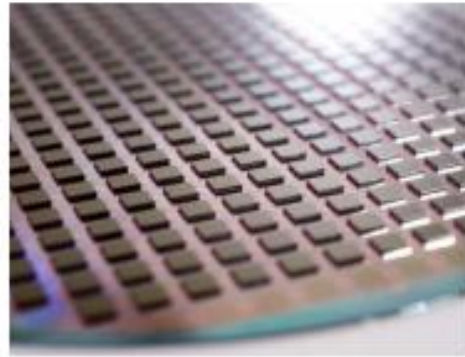
ABF載板垂直顯影系統 (Ampoc Wing)

Ampoc Wing生產ABF載板實況





Laser Heater TC Bonder



- Fast heating and cooling
- Low thermal expansion
- Localized heating





2020年市場狀況與未來展望

2020上半年受到新冠肺炎疫情影响，對全球行動裝置與設備市場造成了莫大之衝擊，其負面影響如各地生產線發生大規模中斷、勞動力不足和交通物流中斷等情況，造成科技產業供應鏈發生無預期之停滯。再加上中美對立加劇，雙方於世界舞台上不斷發生角力。中國疫情後產業與市場狀況，以及美國總統選舉後之可能權力改組等，種種不確定因素也預告了下半年將需面對更大挑戰。

台灣在多年的電子業經驗下，保有硬體上的優勢及完整的上下游供應鏈，揚博代理部份秉持著多年於電子業界的經營理念，仍以審慎的態度持續耕耘，進而積極佈局半導體前段、先進封裝、5G通信/AI人工智能此三大方向。



台灣PCB產業2019年回顧及2020年展望

- 2019年全球電路板產值達到美金683億，較2018年691億美元微幅衰退大約-1.2%。
- 2019年主要PCB生產國市佔率前3名分別為：
 - 台灣:31.4% \equiv (31.3%)
 - 中國:26.5% \uparrow (23.0%)
 - 日本:17.3% \downarrow (19.1%)

2019年雖然台灣仍以31.4%的全球市場占有率奪冠，但中國大陸的占比也達到了26.5%是唯一成長的國家，產值成長率達13.2%，其中最大關鍵就是5G基地台相關產品需求，使其市占率和成長率正快速上升中。

- 2020年IC載板、手機板、藍芽仍扮演PCB產業主要成長動能。
- 2020年下半年預估PCB擴充產能其產品包含5G相關載板、軟板、軟硬接合板、應用市場包含智慧型手機、汽車電子、物聯網、網通等產品市場。
- 2020年設備需求觀察重點：
 - 一、ABF載板高階製程設備需求。
 - 二、各廠商跨入高階產品競爭，包括5G相關載板、類載板、HDI軟板設備需求。
 - 三、電動汽車與安全相關設備需求。



四、財務資訊

最近年度綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	107年度	108年度 (合併)	109年上半年度 (合併)
營業收入		2,400,520	2,482,446	1,269,663
營業毛利		765,833	653,556	332,029
毛利率(%)		31.90	26.33	26.15
營業利益		423,229	354,944	193,177
稅後淨利		342,985	228,519	193,021
每股盈餘(元)		3.00	2.00	1.69



最近年度資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	107年	108年 (合併)	109年上半年 (合併)
流動資產		2,713,049	2,660,223	2,929,904
非流動資產		758,096	708,293	741,272
資產總額		3,471,145	3,368,516	3,671,176
流動負債		938,712	892,531	1,287,065
非流動負債		108,930	126,181	128,635
負債總額		1,047,642	1,018,712	1,415,700



最近年度財務分析

項目	年度	107年	108年 (合併)	109年上半年 (合併)
負債佔資產比 (%)		30.18	30.24	38.56
流動比率(%)		289.02	298.05	227.64
存貨周轉率(次)		1.89	2.19	2.12
權益報酬率(%)		14.66	9.57	8.38



五、未來展望

(一)業務發展方向

(二)競爭優勢





(一) 業務發展方向

➤ 研發創新技術因應未來趨勢之利基設備：

1.5G相關應用載板製程設備

2.軟板及硬板製程設備

3.車載板HDI製程設備

4.設備智慧化

➤ 開發未來新市場客戶：

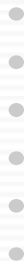
1.東南亞

2.印度



(二) 競爭優勢





Thank you
The End

